



行业动态
Industry News



国内芯片制造业老大“中芯”加盟PFI联盟

2007-10-26 | 编辑: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

来源: eNet -- 半导体国际 - 中国半导体制造业的技术权威网站

中芯国际集成电路制造有限公司(简称“SMIC”)是世界领先的集成电路芯片代工公司之一,今日与国际领先的电子设计创新企业 Cadence 设计系统有限公司宣布SMIC正推出一种基于通用功率格式(CPF)的90纳米低功耗数字参考流程,以及兼容CPF的库。SMIC还宣布其已经加盟功率推进联盟(PFI)。

这种新流程使用了由 SMIC 开发的知识产权,并应用了 Cadence 设计系统有限公司的低功耗解决方案,其设计特点是可提高生产力、管理设计复杂性,并缩短上市时间。这种流程是 Cadence 与 SMIC 努力合作的结晶,使双方的共同客户加快了低功耗设计的速度,迎接低功耗设计挑战。

SMIC参考流程(3.2)采用了Cadence的技术,是一套完整的对应CPF的RTL-to-GDSII低功耗流程,目标是使90纳米系统级芯片设计实现高效功耗利用。它结合了SMIC 90纳米逻辑低漏电1P9M 1.2/1.8/2.5V 标准工艺,以及商用低功耗库支持。该流程在所有必要的设计步骤中都具备功率敏感性,包括逻辑综合过程、仿真、可测性设计、等价验证、硅虚拟原型设计、物理实现与全面的Signoff分析。

“加盟PFI功率推进联盟体现了我们对整个业界范围的低功耗努力的支持,也体现了我们在不断追求向终端用户提供高级低功耗解决方案,” SMIC设计服务处资深处长David Lin表示,“随着高级工艺节点正不断缩小到90纳米以内,有两大问题随之而来:可制造性与可测性。SMIC参考流程基于Si2标准的CPF,是对这些问题的回应,带来了一个有效的高成品率工艺,带来最高的硅片质量。”

“Cadence 欢迎 SMIC 这位新会员加入到功率推进联盟的大家庭,感谢他们对业界发展的努力,” Cadence IC数字及功率推进部副总裁 Chi-Ping Hsu 博士表示,“半导体产业紧密合作,一起推动低功耗技术、设计和制造解决方案,这是至关重要的大事。”

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意

通用功率格式CPF是由Si2批准通过的一种标准格式，用于指定设计过程初期的低功耗技术——实现低功耗技术的分享和重用。Cadence低功耗解决方案是业内最早的全套流程，将逻辑设计、验证、实现与Si2标准的通用功率格式相结合。



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号